

2018-2023年中国印制电路板制造产业市场竞争现状调查与投资战略评估研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国印制电路板制造产业市场竞争现状调查与投资战略评估研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/309714309714.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

据Prismark的统计数据，全球PCB市场约600亿美元，而近五年增长均不超过3%。

2015年受需求疲软、库存调整、货币贬值等因素的影响甚至下滑2.23%，尽管其后有所回暖，却仍仅取得微小增幅，市场整体成长较为缓慢。

成长缓慢的根本原因在于以智能手机为主的PCB传统动能已显疲态。智能手机过去一直是PCB行业的主要驱动力，经历了快速渗透的爆发期之后，逐步进入存量时代，未来恐难再现2G换3G的辉煌，智能手机行业正式步入下半场。而随着移动互联网时代到来，PC计算平台的地位也迅速被移动终端取代，相当多的用户由PC分流向移动终端设备，全球PC出货量自2011年开始持续走低。平板电脑整体亦需求不振。PCB在传统领域增速向下换挡趋势基本确定。

图：PCB传统下游终端全球出货量（亿台）

旧动能的退潮往往意味着新动能的萌发，以汽车电子为代表的下游新兴需求正在逐步接棒，驱动PCB再次成长。可以发现，过去几年尽管PCB需求整体不振，但汽车电子却是行业中为数不多的几个亮点之一，始终保持稳定高速增长。据Prismark对PCB下游各终端市场产值的预测，2016年-2020年增长最快的领域将出现在工控和汽车电子上，CAGR分别达4.9%和4.3%。

与传统汽车相比，新能源车对电子化程度的要求更高，电子装置在传统高级轿车中的成本占比约25%，在新能源车中则达到45%-65%；而一套ADAS又将带来2000-4000美元的汽车电子新需求。在电动化和智能化双轮驱动之下，汽车电子市场迅速扩大，近年均维持着15%以上的年增长率，相应地也带动车用PCB市场持续向上。因此汽车联网、娱乐、节能和安全四大趋势的背后实质都是电子化。作为电子化不可或缺的PCB将深度受益新动能，未来成长趋势非常明确。

图：全球PCB产值及增速

图：2016年PCB全球市场下游应用分布情况

图：全球汽车PCB产值及增速

图：2015-2020年PCB各下游全球产值CAGR预测

汽车板以4-8层多层板为主，安全性要求严格，进入门槛高。汽车板以4-8层多层板为主，其中安全系统和动力系统对安全性的要求非常严格，零不良率是基本要求，进入门槛高。例如汽车安全系统，传统的汽车安全系统主要采用金属基板，而随着汽车ADAS渗透率的提高，对高频PCB板的需求将越来越多。高频PCB要求采用PTFE陶瓷材料，目前只有美国、欧洲等大厂才有能力完成。而动力系统的发动机相关器件则要承受-40~+1500 甚至2000

以上的温度变化，甚至还要承受复杂环境的考验，包括防冲击，防水，防震等，因此新型的耐高温陶瓷基板成为必须。最为常用的是高温共烧（氧化铝）陶瓷PCB，其基板材料

烧结温度在1600°C左右，导体是高熔点的钨或钼，可以同时烧结在一起，相关PCB产品主要由德国的Schweizer、Duwel、Wurth、美国的TTM、日本的CMK与Meiko等供应。

表：PCB下游应用对各类PCB的需求

相比于厮杀激烈的传统PCB市场，汽车板无疑是蓝海市场。汽车PCB准入门槛高，要经过一系列的验证测试，认证周期通常长达2-3年，而一旦通过认证并稳定供应一两个产品周期后，厂商一般不会轻易更换供应商，汽车板厂商因此会享有稳定的毛利率和业绩成长。在消费电子市场饱和竞争后，PCB厂商也更有愿意转做高毛利的汽车PCB，完成产品组合的升级。

我们认为，随着消费电子产业步入高原平台期，未来PCB行业成长将持续分化，行业增长动能将逐步转移到汽车电子等新兴需求上。汽车电子对PCB的驱动效应将日趋显著。

观研天下发布的《2018-2023年中国印制电路板制造产业市场竞争现状调查与投资战略评估研究报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章：全球印制电路板制造发展现状及前景预测

1.1全球印制电路产业总体状况

1.1.1全球印制电路板发展历程

1.1.2全球印制电路板发展趋势

1.1.3全球印制电路板市场规模

1.1.4全球印制电路板应用市场

1.1.5全球印制电路板产品种类

1.2全球印制电路产业竞争格局

1.2.1全球印制电路板行业企业竞争格局

- (1) 全球PCB企业规模分布
- (2) 全球PCB企业集中度分析
- (3) 跨国公司在中国的竞争策略分析
- (4) 全球PCB重点企业市场竞争分析
- 1) 美国MULTEK集团
- 2) 惠亚 (VIASYSTEMS) 集团竞争力分析
- 3) 森米纳集团 (Sanmina-SCI Corporation) 竞争力分析
- 4) 日本株式会社藤仓 (Fujikura) 竞争力分析
- 5) 日立化成工业株式会社 (HITACHICHEMICAL) 竞争力分析
- 1.2.2 全球印制电路板行业区域竞争格局
 - (1) 全球PCB行业区域规模分布
 - (2) 全球PCB企业区域集中度分布
- 1.3 重点区域印制电路行业发展情况
 - 1.3.1 北美市场情况分析
 - (1) 北美市场规模
 - (2) 北美企业竞争情况
 - 1.3.2 欧洲市场情况分析
 - (1) 欧洲市场规模
 - (2) 欧洲企业竞争情况
 - 1.3.3 日本市场格局
 - (1) 日本市场规模
 - (2) 日本企业竞争情况
 - 1.3.4 亚洲市场格局
 - (1) 亚洲市场规模
 - (2) 亚洲企业竞争情况
- 1.4 全球印制电路行业发展前景预测
 - 1.4.1 全球印制电路板制造产值规模预测
 - 1.4.2 全球印制电路板制造产业转移路径

第二章：中国印制电路板制造发展现状及前景预测

- 2.1 中国印制电路板制造行业发展现状分析
 - 2.1.1 国内印制电路板发展现状
 - 2.1.2 印制电路板制造行业发展主要特点
 - 2.1.3 印制电路板制造行业规模及财务指标分析
 - (1) 印制电路板制造行业规模分析

- (2) 印制电路板制造行业盈利能力分析
- (3) 印制电路板制造行业运营能力分析
- (4) 印制电路板制造行业偿债能力分析
- (5) 印制电路板制造行业发展能力分析
- 2.2 印制电路板制造行业经济指标分析
 - 2.2.1 印制电路板制造行业主要经济效益影响因素
 - (1) 有利因素
 - (2) 不利因素
 - 2.2.2 印制电路板制造行业经济指标分析
- 2.3 印制电路板制造行业供需平衡分析
 - 2.3.1 全国印制电路板制造行业供给情况分析
 - (1) 全国印制电路板制造行业总产值分析
 - (2) 全国印制电路板制造行业产成品分析
 - 2.3.2 全国印制电路板制造行业需求情况分析
 - (1) 全国印制电路板制造行业销售产值分析
 - (2) 全国印制电路板制造行业销售收入分析
 - 2.3.3 全国印制电路板制造行业产销率分析
- 2.4 印制电路板制造行业进出口市场分析
 - 2.4.1 印制电路板制造行业进出口状况综述
 - 2.4.2 印制电路板制造行业出口市场分析
 - (1) 行业出口整体情况
 - (2) 行业出口产品结构分析
 - 2.4.3 印制电路板制造行业进口市场分析
 - (1) 行业进口整体情况
 - (2) 行业进口产品结构
 - 2.4.4 印制电路板制造行业进出口前景分析
 - (1) 印制电路板制造行业出口前景分析
 - (2) 印制电路板制造行业进口前景分析
- 2.5 印制电路板制造行业竞争市场分析
 - 2.5.1 现有竞争者之间的竞争
 - 2.5.2 关键要素的供应商议价能力分析
 - 2.5.3 购买者议价能力分析
 - 2.5.4 行业潜在进入者分析
 - 2.5.5 替代品风险分析
- 2.6 中国印制电路板制造行业发展前景预测

2.6.1印制电路板制造行业发展趋势分析

2.6.2印制电路板制造行业发展前景预测

第三章：印制电路板制造行业产业链分析

3.1印制电路板制造行业产业链概况

3.1.1印制电路板制造行业产业链简介

3.1.2印制电路板制造行业产业链现状分析

(1) 上游原材料价格上涨提高行业成本

(2) 下游市场需求激增拓展行业空间

3.2行业产品主要原料市场分析

3.2.1玻纤纱/布市场情况分析

(1) 玻纤纱/布市场分析

(2) 玻纤纱/布产地分布

3.2.2专用木浆纸市场情况分析

(1) 木浆市场分析

(2) 木浆价格走势

3.2.3环氧树脂（EP）市场情况分析

(1) 环氧树脂市场分析

1) 国内环氧树脂分析

(2) 环氧树脂竞争情况

(3) 环氧树脂供应预测

3.2.4铜箔市场情况分析

(1) 铜箔材产量分析

(2) 铜箔材价格分析

(3) 铜箔材应用领域分析

(4) 铜箔材市场需求分析

3.2.5覆铜板市场情况分析

(1) 覆铜板市场发展状况分析

(2) 覆铜板市场进出口分析

(3) 覆铜板市场发展趋势分析

3.3行业主要产品市场分析

3.3.1行业主要产品结构特征

(1) 产品具体分类

(2) 产品结构变化

3.3.2单面板产品市场分析

3.3.3多层板产品市场分析

3.3.4挠性面板市场分析

3.3.5软硬结合板市场分析

3.3.6HDI板产品市场分析

3.3.7IC载板产品市场分析

3.4行业产品主要应用领域分析

3.4.1印制电路板（PCB）主要应用领域概况

3.4.2计算机领域对行业的需求分析

（1）计算机市场发展状况分析

（2）计算机PCB板需求分析

3.4.3通讯设备领域对行业的需求分析

（1）通讯设备市场发展状况分析

1）通信领域投资规模

2）全国移动电话户数

3）移动电话交换机容量

4）我国通讯设备行业经营情况

5）主要通讯设备制造商分析

6）行业发展趋势及前景预测

（2）通讯设备市场PCB板需求分析

3.4.4汽车电子领域对行业的需求分析

（1）汽车电子市场发展状况分析

1）汽车电子产业规模

2）技术发展对行业格局的影响

3）汽车电子各细分市场产品生命周期

4）汽车电子各细分市场规模和平均利润率

（2）汽车电子市场PCB板需求分析

3.4.5家用电器对行业的需求分析

（1）家用电器市场发展状况分析

1）生产情况

2）经济效益

（2）家用电器市场PCB板需求分析

3.4.6消费电子领域对行业的需求分析

（1）消费电子市场发展状况分析

（2）消费电子市场PCB板需求分析

3.4.7国防科教领域对行业的需求分析

3.4.8工业控制市场对行业的需求分析

第四章：印制电路板制造行业区域市场发展状况分析

4.1印制电路板制造区域市场总体发展状况分析

4.1.1行业区域结构总体特征

4.1.2行业区域集中度分析

4.2重点印制电路板制造发展状况分析

4.2.1广东省印制电路板制造行业基本情况分析

(1) 行业产销规模分析

(2) 行业企业及亏损企业数量

(3) 行业亏损额度及变化情况

4.2.2上海市印制电路板制造行业基本情况分析

(1) 行业产销规模分析

(2) 行业企业及亏损企业数量

(3) 行业亏损额度及变化情况

4.2.3江苏省印制电路板制造行业基本情况分析

(1) 行业产销规模分析

(2) 行业企业及亏损企业数量

(3) 行业亏损额度及变化情况

4.2.4浙江省印制电路板制造行业基本情况分析

(1) 行业产销规模分析

(2) 行业企业及亏损企业数量

(3) 行业亏损额度及变化情况

4.2.5山东省印制电路板制造行业基本情况分析

(1) 行业产销规模分析

(2) 行业企业及亏损企业数量

(3) 行业亏损额度及变化情况

4.2.6江西省印制电路板制造行业基本情况分析

(1) 行业产销规模分析

(2) 行业企业及亏损企业数量

(3) 行业亏损额度及变化情况

第五章：印制电路板制造行业领先制造商生产经营分析

5.1印制电路板制造企业基本情况

5.2印制电路板制造行业领先制造商生产经营分析

5.2.1广东汕头超声电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

5.2.2珠海方正科技多层电路板有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

5.2.3伟创力电子技术（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

5.2.4健鼎（无锡）电子有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

5.2.5广州添利线路板有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

5.2.6广东生益科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

5.2.7沪士电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

5.2.8深圳市兴森快捷电路科技有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

5.2.9天津普林电路股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

5.2.10广东超华科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第六章：印制电路板制造行业投资分析及建议

6.1印制电路板制造行业投资特性分析

6.1.1印制电路板制造行业进入壁垒分析

6.1.2印制电路板制造行业盈利模式分析

- (1) 采购模式
- (2) 生产模式
- (3) 销售模式

6.1.3印制电路板制造行业盈利因素分析

6.2印制电路板制造行业投资兼并与重组整合分析

6.2.1印制电路板制造行业投资兼并与重组整合概况

6.2.2外资印制电路板制造企业投资兼并与重组整合分析

6.2.3国内印制电路板制造企业投资兼并与重组整合分析

6.3印制电路板制造行业投资机会与投资风险分析

6.3.1印制电路板制造行业投资机会分析

- (1) 4G技术推广
 - 1) 运营商发展情况
 - 2) 4G用户数量预测
 - 3) 4G终端需求规模预测
- (2) 柔性电路板普及

6.3.2印制电路板制造行业投资风险分析

6.4印制电路板制造行业投资建议

6.4.1印制电路板制造行业投资价值

6.4.2印制电路板制造行业投资方式建议

图表目录：

图表1：印制电路板发展轨迹

图表2：2016-2017年各大机构发布全球PCB市场总产值（单位：亿美元）

图表3：2016-2017年各大机构发布PCB市场总产值变化趋势图（单位：亿美元，%）

图表4：2016-2017年全球PCB应用市场分布及其增速（单位：亿美元，%）

图表5：2017年全球PCB应用市场占比图（单位：%）

图表6：2017年全球PCB种类分布（单位：%）

图表7：2017年产值一亿美元以上PCB企业前十排名（单位：百万美元）

图表8：2017年全球产能前十企业产能占比图（单位：百万美元）

图表9：2016全球产值一亿美元以上PCB企业区域集中度（单位：家）

图表10：美国MULTEK集团分析

图表11：惠亚（VIASYSTEMS）集团分析

图表12：森米纳集团（Sanmina-SCI Corporation）分析

图表13：日本株式会社藤仓（Fujikura）分析

图表14：日立化成工业株式会社（HITACHICHEMICAL）分析

图表15：2016-2017年全球各地区PCB产值（单位：亿美元，%）

图表16：2017年全球各区域PCB产量比重图（单位%）

图表17：2017年全球PCB前百企业产能区域分布（单位：百万美元）

图表详见报告正文（BGZQJP）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/309714309714.html>